



Ref.: **POLY / POLY DT**



Funções:
Remover a bainha exterior - Desnudar o isolamento

Capacidade: Ref. **POLY DT**: 50 mm² a 630 mm².

Ref. **POLY**: 35 mm² a 630 mm²

Para todos os materiais ex: XLPE / EPR

Batente adaptável para desnudar o isolamento (20 à 110 mm)

Fornecida com 3 jogos de chapas de protecção contra a fricção

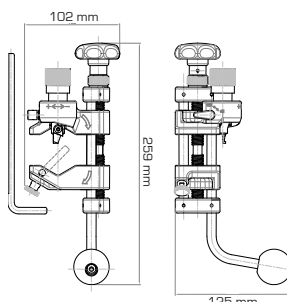
N° nomenclatura ERDF POLY DT: N°07.57.764

Peças sobressalentes:

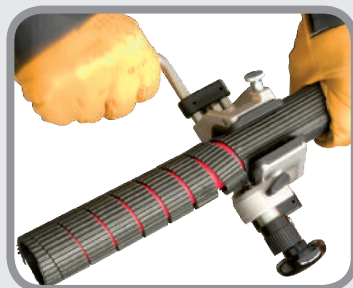
Lâmina: ref. **LAME POLYDT**

N° Nomenclatura: 07.57.765

Jogo de protecções: ref. **PLAQPOLY**



FUNÇÕES



Remover a protecção mecânica



Remover a bainha exterior



Desnudar o isolamento

Ref.: **OUT SCP NP / OUT SCP NP DT**



Funções:
Fazer uma incisão no semicondutor pelável
Maquinar o semicondutor não pelável

Capacidade: Ref. **OUT SCP NP DT**: 50 mm² a 630 mm².

Ref. **OUT SCP NP**: 35 mm² a 630 mm².

Para todos os materiais ex: XLPE / EPR

Para todos os tipos de semicondutores

Comprimento do semicondutor restante com batente ajustável

Ref. **OUT SCP NP DT**: 30 a 50 mm

Ref. **OUT SCP NP**: 25 a 55 mm

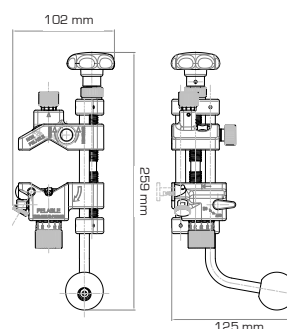
N° nomenclatura ERDF OUT SCP NP DT: N°07.57.766

Lâminas de reserva:

Ref. **LAME OUT SCP** (Semicondutor pelável)

Ref. **LAME OUT SCNP** (Semicondutor não pelável)

N° Nomenclatura: 07.57.767 (o conjunto)



FUNÇÕES



Fazer uma incisão e remover o semicondutor pelável



Maquinar o semicondutor não pelável